

东方证券股份有限公司
关于烟台德邦科技股份有限公司
2024 年度持续督导跟踪报告

东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”、“保荐机构”）作为正在履行烟台德邦科技股份有限公司（以下简称“德邦科技”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，负责德邦科技上市后的持续督导工作并出具本年度持续督导跟踪报告。

一、持续督导工作情况

序号	工作内容	实施情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划	保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导制度，并制定了相应的工作计划
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案	保荐机构已与德邦科技签订《保荐协议》，已明确双方在持续督导期间的权利和义务，并已报上海证券交易所备案
3	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作	保荐机构通过日常沟通、定期及不定期回访等方式了解德邦科技业务经营情况，对德邦科技开展持续督导工作
4	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告	在本持续督导期间，德邦科技未发生按相关规定须保荐机构公开发表声明的违法违规情况
5	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等	在本持续督导期间，德邦科技未发生违法违规或违背承诺等事项
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺	在本持续督导期间，保荐机构督导德邦科技及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，切实履行其所做出的各项承诺
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等	保荐机构已督促德邦科技进一步完善公司的治理制度并严格执行
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部	保荐机构已督促德邦科技建立健全相关内部控制制度，且得到了有效执行，未发现德邦科

序号	工作内容	实施情况
	审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序和规则等	技内部控制制度执行存在失效的情况
9	督促上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分的理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	保荐机构已督促德邦科技按照中国证监会、上海证券交易所相关规定建立健全信息披露制度，并按制度规定严格执行，并已审阅信息披露文件及其他相关文件
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正或补充，公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告；对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告	在本持续督导期间，保荐机构对德邦科技的信息披露文件进行了事前或事后的及时审阅，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完成内部控制制度，采取措施予以纠正	在本持续督导期间，德邦科技及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在前述情况
12	持续关注上市公司及其控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告	在本持续督导期间，德邦科技及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况
13	关注公共传媒关于上市公司的报告，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告	在本持续督导期间，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况
14	发现以下情形之一的，督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）公司出现《保荐办法》第七十条规定的情形；（四）公司不配合持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形	在本持续督导期间，德邦科技未发生前述情况
15	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量	保荐机构已制定现场检查的相关工作计划，并明确了具体的检查工作要求
16	上市公司出现以下情形之一的，保荐人应自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内，对上市公司进行专项现场检查：（一）控股股东、实际控制人或其他关联方非经营性占用上市公司资金；（二）违规为他人提供担保；（三）违规使用募集资金；（四）	在本持续督导期间，德邦科技不存在前述情形

序号	工作内容	实施情况
	违规进行证券投资、套期保值业务等；（五）关联交易显失公允或未履行审批程序和信息披露义务；（六）业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降 50%以上；（七）上海证券交易所要求的其他情形	

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

在本持续督导期间，保荐机构和保荐代表人未发现德邦科技存在需整改的事项。

三、重大风险事项

公司目前面临的风险因素主要如下：

（一）核心竞争力风险

1、产品迭代与技术开发风险

公司是一家专业从事高端电子封装材料研发及产业化的国家级专精特新重点“小巨人”企业，产品广泛应用于集成电路封装、智能终端封装和新能源应用等新兴产业领域。公司所处行业领域技术升级及产品更新迭代速度较快，且公司面临的竞争对手主要为国际知名企业。公司需要持续研发符合客户需求的新型产品，并与竞争对手展开技术竞争，对公司的研发创新能力、研发响应速度、现有储备技术与行业新需求的匹配性构成一定挑战。

如果公司不能准确地把握下游行业的发展趋势，或者公司的研发创新能力、研发响应速度、现有储备技术无法满足客户对于新型封装工艺和应用场景的需求，或在与竞争对手的直接技术竞争中处于劣势，这将导致公司产品与下游客户的技术需求适配性下降，进而对公司的产品销售、业务开拓和盈利能力造成不利影响。

2、核心技术泄密的风险

公司拥有多项与电子级粘合剂制备与功能性薄膜材料制程相关的核心技术，公司的主要研发竞争力在于产品配方的持续研发创新以及工艺流程的优化改进。若公司产品配方与工艺流程被复制或泄露，公司的市场竞争力将受到不利影响。

（二）经营风险

公司产品主要应用于集成电路封装、智能终端封装和新能源应用等新兴产业领域，并以智能终端封装、新能源应用为主，集成电路封装领域占比较低。为满足下游客户需求，公司需要持续进行产品研发及升级迭代，如果未来公司集成电路封装材料的研发效果及产品技术水平未能达到下游客户要求，或者产品研发进度落后于主要竞争对手，或者产品的市场推广进度未及预期，公司集成电路封装材料的收入占比存在持续偏低甚至下降的风险。

2024 年，公司实现营业收入 116,675.21 万元，保持持续稳定增长，但净利润略有下降。与国内外主要竞争对手相比，公司的经营规模相对较小，抵御经营风险的能力相对偏弱。公司当前业务经营能力仍相对有限，在市场销售、研发投入等方面仍有不足，面对日益增长的客户需求，可能无法承接所有客户的订单需求，因而错失部分业务机会，导致公司营业收入的增速存在放缓的可能。

（三）财务风险

根据应用领域与场景的差异，公司产品包括集成电路封装材料、智能终端封装材料、新能源应用材料以及高端装备应用材料这四大类别。在报告期内，公司业务整体呈现出迅猛发展的态势。然而，不同类别产品的毛利率水平，主要受到行业现状、市场供求关系、产品技术特性、产品更新换代节奏以及公司销售与市场策略等多种因素的综合作用，进而存在一定差异。

鉴于公司各类产品所面临的市场竞争环境各不相同，产品所处的生命周期阶段和更新迭代进度也有所区别，销售结构存在差异，并且同一产品的单位成本金额持续受到原材料价格波动的影响，公司面临着因上述因素导致毛利率下降的风险。倘若公司无法依据市场变化及时推进产品技术升级，致使产品技术缺乏先进性，或者公司市场推广效果未达预期，造成高毛利产品销售增速减缓、收入占比降低，又或者原材料价格大幅上扬，都有可能致使公司毛利率水平进一步下滑，进而对公司的经营业绩与盈利能力产生负面影响。

（四）宏观环境风险

封装材料作为一个已充分竞争的行业，近年来行业集中度有所提高，但国内企业产品依然以中低端为主，世界知名品牌跨国公司在品牌及技术具有先发优势，

不断通过在国内建立合资企业或生产基地降低生产成本,使得公司面临一定的市场竞争风险。其次国内环保政策、国际贸易保护等有可能导致原材料价格上涨、断供或产品出口受限等风险。尽管公司目前主营业务所处市场发展趋于良性循环,但国际贸易环境更趋复杂严峻和不确定,国内宏观经济增长不及预期或行业政策重大调整对公司下游行业产生不利影响,也将使公司也面临着各种风险及挑战。

四、重大违规事项

在本持续督导期间,公司不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2024 年度,公司主要财务数据及指标如下所示:

主要财务数据	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	1,166,752,095.17	931,975,150.19	25.19
归属于上市公司股东的净利润(元)	97,429,117.04	102,946,215.94	-5.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	83,657,037.64	87,650,670.12	-4.56
经营活动产生的现金流量净额(元)	378,978,438.28	38,878,563.51	874.77
主要财务数据	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,294,036,142.65	2,270,384,327.59	1.04
总资产(元)	2,969,733,400.69	2,740,678,337.69	8.36
主要财务指标	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.69	0.72	-4.17%
稀释每股收益(元/股)	0.69	0.72	-4.17%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.59	0.62	-4.84%
加权平均净资产收益率(%)	4.30	4.60	减少 0.3 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.69	3.92	减少 0.23 个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	5.73	6.65	减少 0.92 个百分点

上述主要财务数据及指标的变动原因如下:

报告期内,公司营业收入达到 116,675.21 万元,同比增长 25.19%,主要原因得益于公司在集成电路、智能终端、新能源和高端装备四个业务板块的市场机

遇把握与战略布局。在集成电路板块，半导体行业的复苏带动了下游稼动率回升。公司通过持续完善和丰富产品系列，成功开拓了更多的业务增长点。智能终端板块则受益于消费电子行业全年的小幅增长。公司积极挖掘新客户与应用场景，新产品不断突破，高附加值产品的销量稳步提升，市场份额也随之扩大。新能源板块中，新能源汽车市场的蓬勃发展使得全年出货量持续增长。高端装备板块在智能驾驶、智能座舱以及汽车轻量化等领域出现新需求，公司聚焦重点客户和项目，发挥协同效应，促使四大业务板块的营业收入均实现了不同程度的增长。

报告期内，归属于母公司所有者的净利润为 9,742.91 万元，同比下降 5.36%，主要原因系报告期内，集成电路、智能终端和高端装备板块的毛利率呈现稳步上升态势，而新能源板块受部分产品降价影响，毛利率有所下滑。同时，公司为保持竞争力，持续加大研发投入，积极开拓海内外市场，相关费用同比增加。这些因素综合作用，导致报告期内公司净利润出现小幅下降。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长 874.77%。随着营业收入的增加，销售商品收到的现金流入显著提升。同时，公司持有的票据到期托收及贴现业务增加，进一步促进了经营活动现金流入的增长，从而使得经营活动现金流量净额大幅增加。

综上，公司 2024 年度主要财务数据及财务指标变动具备合理性。

六、核心竞争力的变化情况

（一）研发、生产优势

公司专注于高端电子封装材料的研发和产业化，公司深知高端电子封装材料的技术研发和新产品开发能力对企业持续经营的重要性，因此积极布局集成电路、智能终端、新能源等前沿领域。在国家高层次海外引进人才领衔的核心科研团队长期钻研下，公司在集成电路封装、智能终端封装、新能源应用等领域实现技术突破，在高端电子封装材料领域构建起了完整的研发体系，掌握核心技术并拥有完全自主知识产权。

公司具备快速的市场响应能力，公司下游应用领域存在较为明显的产品周期短、技术更新换代快、消费热点切换迅速的特点，这就要求上游材料供应商具有快速研发能力，以适配客户的产品工艺需求。

与此同时，公司所面向的客户主要为行业内知名品牌客户，下游客户对于供应链管理极为严格，一般要求即时发货，采购周期较短。公司已建造了行业领先的高端电子封装材料智能制造工厂，并拥有一批对行业、产品理解深刻的生产队伍，生产管理水平较高，能够配合客户的实时订单要求，迅速组织生产，实现供货。

（二）客户资源优势

高端电子封装材料，作为终端产品内部构件性能、稳定性及结构密封防护的关键要素，对于终端产品品质有着决定性的影响。因此，原材料的品质成为终端产品品牌商选择供应商时的核心考量因素，进入其供应商名录门槛颇高。随着下游高端应用领域的蓬勃发展，公司紧密围绕客户需求，开发细分产品，确保供应商地位的稳固，构筑起坚实的市场壁垒。多年来，公司凭借卓越的技术实力，成功将芯片固晶材料、晶圆 UV 膜等集成电路封装材料批量供应给国内知名封测企业，包括了华天科技、通富微电、长电科技、日月新等全球知名封测厂商；智能终端封装材料亦广泛应用于国内外知名品牌，包括苹果公司、华为公司、小米科技等智能终端领域的全球龙头企业；同时，宁德时代、中创新航、比亚迪、通威股份、阿特斯等新能源领域的知名企业亦成为公司的合作伙伴，这些优质客户资源为公司的发展提供了强有力的支撑。

为深化与客户合作，公司不断加强与终端应用品牌的技术交流，精准把握市场脉动和技术趋势，确保研发方向与产品迭代升级紧扣市场需求。公司依托核心技术，向客户提供高端电子封装材料及其解决方案，将技术与客户资源双重优势融合，进一步巩固市场地位，提升竞争力，引领行业发展。

（三）丰富的系统解决方案优势

公司在提供高性能产品的同时，更凭借扎实的技术研发实力和深厚的专有技术积累，为客户提供全方位的系统解决方案。公司多年积累的研发和应用数据库，能够实现更加精准高效研发。

从产品设计之初到生产应用培训，再到持续的售后服务与产品技术迭代，公司始终坚持以客户需求为核心，致力于提供一站式的高端电子封装材料解决方案。公司深入参与客户新产品设计的各个阶段，提供包括性能提升方案、材料配方设

计、样品测试在内的全面服务。通过定制化服务，精准解决客户的个性化问题，实现与客户的协同作业，从而大幅提升客户满意度，并深化与下游客户的合作关系。在高端电子封装材料领域，产品性能受多种因素影响。因此，公司紧密与客户合作，共同设计出满足特定工艺参数、胶体特性、使用环境、老化参数和可靠性要求的产品解决方案。这种以客户需求为导向的服务模式，使公司能够不断优化产品性能，满足市场对高质量封装材料的复杂需求。

公司丰富的系统解决方案优势不仅体现在技术实力上，更体现在对客户需求的深度理解和满足上。这种优势不仅提升了客户的满意度和合作深度，更巩固了公司在高端电子封装材料领域的市场领先地位。

七、研发支出变化及研发进展

报告期内，公司研发投入达 6,685.02 万元，较上年同期增长 7.90%，研发费用占营业收入比例为 5.73%。持续增长的投入，为技术创新与产品升级提供资金保障，助力公司凭借创新产品提升市场竞争力与品牌影响力。

公司高度重视科研人才队伍的建设，加大引才力度、完善培养体系，打造高水准的科研队伍，为研发项目推进、技术突破提供人力支撑。截至报告期末，公司共拥有国家级海外高层次专家 2 人，研发团队扩充至 155 人，同比增幅为 15.67%，占公司总人数的 20.53%。

（一）核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

高端电子封装材料不仅承担着粘合、密封、保护等传统角色，还需具备导电、导热、屏蔽、绝缘、防水和耐汗液等特殊功能。针对不同的应用领域：集成电路封装、智能终端封装、新能源动力电池封装、光伏电池封装等，产品需求各异，其核心技术主要集中于配方设计和复配，涉及基体树脂的选择与改性、填料的挑选与复配、表面处理以及助剂的选择与复配等方面。在这些元素间的精密配合技术及工艺混合技术是高端电子封装材料的核心竞争力所在。

材料企业的创新对高分子合成技术、实验室配方调配、材料实验数据储备与处理等方面有较高的要求，需要行业内企业具备核心研发能力，并根据客户需求研究开发出满足特定要求的产品。功能性封装材料行业具备覆盖范围广、细分品种多的特征，材料研发需要经过长期且持续的积累过程，随着人工智能和机器人

技术的进步，未来的封装材料生产将更加趋向智能化和自动化，以提高生产效率，降低人工成本，提高产品品质。随着双碳战略的实施，绿色环保越来越重要，高污染、高能耗的产品、产能将被替代、被淘汰，绿色环保的水基型、热熔型、无溶剂型、紫外光固化型、高固含量型、生物降解型等环境友好型封装材料产品将得到广泛应用。

经过二十多年的技术积累和沉淀，公司建立了涵盖环氧、有机硅、丙烯酸、聚氨酯电子级树脂、填料、助剂等的复配改性技术平台，能够复配出具有不同理化性能和功能性的材料，并迅速实现产品的升级换代。公司也实现了特种单体、树脂等的自主合成及改性，推进了关键原材料的国产化进程，并提升了产品的核心竞争力。在国家高层次海外引进人才的带领下，公司的核心技术团队在集成电路封装、智能终端封装、新能源应用等领域取得了突破性进展，并建立了完整的研发生产体系和相关核心技术，包括低致敏高分子材料合成、树脂及特殊粘接剂自主合成、专有增韧剂合成、高分子材料接枝改性技术、防静电晶圆切割易捡取技术、高导热界面材料的润湿分散技术等。

（二）报告期内获得的研发成果

1、知识产权项目情况

2024 年度，公司及其子公司获得的知识产权如下表所示：

项目	本年新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	70	28	788	336
实用新型专利	2	1	44	42
外观设计专利	-	-	1	1
软件著作权	-	-	6	6
其他	-	-	-	-
合计	72	29	839	385

2、在研项目情况

公司及子公司的在研项目具体明细如下：

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	半导体用精密涂布膜材料研发	2,000.00	281.64	1,736.76	应用拓展阶段	研发适用于包括 CIS 传感器、OLED 面板、MEMS 传感器、LED 框架、IRCF 等各领域用 UV 减粘胶带	国际先进	UV 减粘膜主要应用于 CIS 传感器、OLED 面板、MEMS 传感器、LED 框架、IRCF 等半导体封装领域。
2	电芯粘接耐电解液材料研发	1,800.00	318.54	1,566.22	应用拓展阶段	研发耐电解液腐蚀，高粘接力，不与电解液反应，不影响锂电池电性能，提高锂电池性能材料	国际先进	电芯粘接耐电解液材料主要用于电芯内部和外部的粘接、密封和固定，起到保护电芯和提高电芯性能的作用，应用于智能手机、笔记本电脑等电子产品、新能源动力电池、储能电池等领域。
3	电子丙烯酸材料研发	2,100.00	599.40	1,627.37	应用拓展阶段	研发不含致敏单体，具有高粘接力、高可靠性及较好的耐化性材料	国际先进	该技术产品具有低致敏性，在智能终端里可穿戴电子产品制造领域中应用广泛，适用于制造各种穿戴电子产品，如 TWS 耳机、智能手表等。
4	电子组装防护特种有机硅材料研发	1,200.00	378.40	1,009.53	应用拓展阶段	研发施胶可满足点胶、喷胶等多种不同条件需求，施胶后 15min 可通过气密性测试验证，粘接强度 $\geq 4\text{MPa}$ 。材料	国际先进	电子组装防护特种有机硅材料，具有优异的耐高温、耐化学性、抗 UV 等特性，能够有效保护电子元器件，提高电子产品的稳定性和可靠性，延长其使用寿命。广泛应用于手机、平板电脑、LED 灯具、汽车电子、医疗电子等领域。
5	高导热聚合物热界面材料开发及产业化和原材料国产化	3,200.00	722.28	2,775.96	应用拓展阶段	原材料国产化，研发可自动化点胶，具有高可靠性和高覆盖率的导热界面材料	国内领先	高导热聚合物热界面材料是一种高性能的散热材料，可以有效地提高电子元器件的散热能力，保障电子产品的稳定性和可靠性。在电子、通信、汽车、工业控制等领域得到广泛应

								用。
6	光伏叠晶材料研发	1,600.00	389.42	1,422.53	应用拓展阶段	研发粘接强度高，模量低，体积电阻率低，210 电池不碎片的材料	国内领先	光伏叠晶材料是太阳能电池制造的关键材料之一，主要应用于太阳能电池、环保节能、新能源、科技创新等领域。
7	新能源动力电池用粘接材料研发	1,800.00	676.88	1,654.24	应用拓展阶段	研发具有超高性价比、高粘度强度、适宜模量、优异的耐老化性能以及系列化的导热性材料	国际先进	广泛应用于新能源动力电池以及储能电池用粘接，可以提高电池组件的连接和固定效果，保证电池组件的安全和稳定性。
8	电子环氧及聚酰胺材料研发	1,200.00	621.15	843.69	应用拓展阶段	在国内规模组装厂商推广，已通过客户验证	国内领先	广泛应用于温度敏感元器件的结构粘接，可以提高封装组件的耐湿热和抗跌落效果，保证封装组件的稳定性。
9	摄像头模组用AA制程材料研究开发项目	500.00	171.62	211.32	应用拓展阶段	研发适用于摄像模组封装过程中的具有高粘接强度，高可靠性的一系列 AA 制程胶黏剂	国内领先	广泛应用于摄像模组封装过程中，提高包含图像传感器、镜座、马达、镜头等零配件的组装准确性，保证摄像模组的使用稳定性。
10	反应型聚氨酯热熔胶材料研发	800.00	584.82	584.82	应用拓展阶段	研发适用于电子消费品类组装与结构粘接；在主流智能手机及耳机领域，车载电子类占据较大市场份额	国内领先	适用于消费电子类的结构粘接，减少螺丝等应用，增加结构的密封性，减轻期间的重量，提高使用体验。
11	高导热导电胶关键技术研究及产品开发	500.00	109.55	109.55	应用拓展阶段	导热>40W/m.K,应用国内高阶 IC 封装产品	国际先进	随着薄型化，微型化，高密度等封装需求，封装材料导热性相对提高，现形材料难以满足，故需要开发更高导热封装材料。
合计	/	16,700.00	4,853.70	13,541.99	/	/	/	/

八、 新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

九、 募集资金的使用情况及是否合规

（一）首次公开发行股票

根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可〔2022〕1527 号文《关于同意烟台德邦科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，烟台德邦科技股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,556.00 万股，每股发行价格 46.12 元，募集资金总额为 164,002.72 万元，扣除不含税发行费用 152,543,951.12 元后，本公司本次募集资金净额为 1,487,483,248.88 元。

截至 2024 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资金存储账户余额为人民币 122,391,959.18 元，募集资金使用情况具体如下：

单位：元

项 目	金额（元）
募集资金到账验资金额	1,504,132,893.44
减：置换以自筹资金预先支付的发行费用	7,283,018.76
支付发行费用	9,366,625.80
募集资金净额	1,487,483,248.88
减：募投项目投入	547,505,382.57
超募部分永久补充流动资金	406,000,000.00
加：扣除手续费后利息收入和理财收益	31,144,092.87
保函保证金退回	730,000.00
使用闲置募集资金购买大额存单或理财产品净额	443,460,000.00
截止 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额	122,391,959.18

综上，公司 2024 年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范

运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司控股股东为解海华、陈田安、王建斌、林国成及陈昕，持有公司 46,748,475 股股份，持股比例为 32.87%。公司实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员直接及间接持有公司股份的情况如下：

单位：股

姓名	职务	直接持股数	间接持股数	合计持股数	持股比例
解海华	董事长	15,064,154	4,989,526	20,053,680	14.10%
陈田安	董事、总经理、核心技术人员	3,093,256	-	3,093,256	2.17%
王建斌	董事、副总经理、核心技术人员	8,661,115	-	8,661,115	6.09%
林国成	董事	13,208,201	-	13,208,201	9.29%
王艺涵	董事	-	-	-	-
杨柳	董事	-	-	-	-
杨德仁（离任）	独立董事	-	-	-	-
唐云	独立董事	-	-	-	-
宋红松	独立董事	-	-	-	-
李清	监事	-	61,766	61,766	0.04%
陈丽	监事	-	66,975	66,975	0.05%
赵倩	监事	-	-	-	-
陈昕	副总经理	1,732,223	-	1,732,223	1.22%
于杰	副总经理、董事会秘书、财务总监	-	3,897,798	3,897,798	2.74%
徐友志	副总经理、核心技术人员	-	-	-	-
姜贵琳	核心技术人员	-	74,238	74,238	0.05%
潘光君	核心技术人员	-	37,416	37,416	0.03%

姜云	核心技术人员	-	7,442	7,442	0.01%
合计		41,758,949	9,135,161	50,894,110	35.78%

截至 2024 年 12 月 31 日，董事长解海华所持公司 75.00 万股股份存在被司法冻结的情形，公司已于 2023 年 6 月 2 日发布《烟台德邦科技股份有限公司关于股东所持公司部分股份被司法冻结的公告》（公告编号：2023-024）对相关信息进行披露。除此之外，上述其他人员持有的德邦科技股份均不存在质押、冻结及减持的情形。

十一、本所或者保荐机构认为应当发表意见的其他事项

截至本持续督导跟踪报告出具之日，不存在保荐机构认为应当发表意见的其他事项。

（以下无正文）

（本页无正文，为《东方证券股份有限公司关于烟台德邦科技股份有限公司
2024 年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

王同胜

王国胜

李天雄

李天雄



东方证券股份有限公司

2025 年 4 月 18 日